

JASDAQ
Listed Company 6323

2007年2月期決算説明会資料

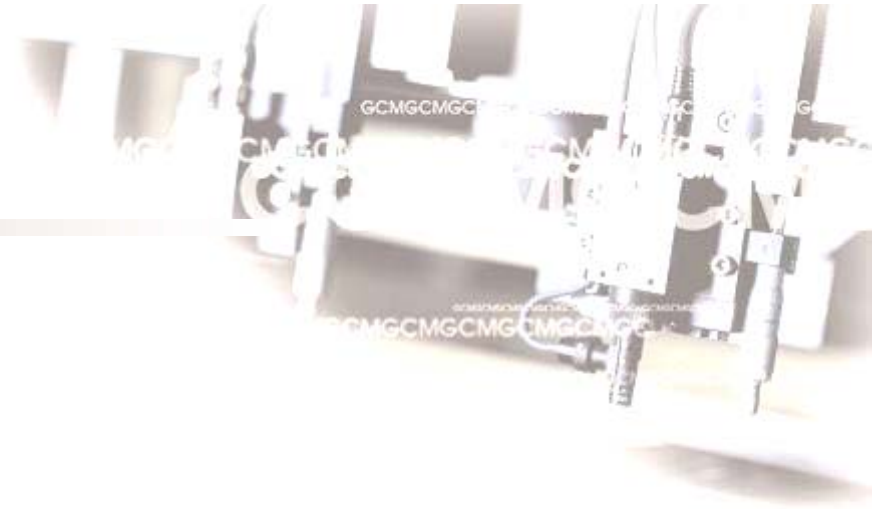
樂華科技

樂華科技

2007年4月25日

RORZE CORPORATION

RORZE



2007年2月期 決算概要

2007年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	9,795	13,404	136.8%	<ul style="list-style-type: none"> ・国内、台湾、韓国など海外の半導体メーカーの新規設備投資への対応 ・欧州での販売強化 ・韓国、台湾など海外を中心としたガラス基板搬送装置・ガラスカッティングマシンの受注増加
売上総利益	2,757	3,810	138.2%	<p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売上増収効果 ・台湾子会社の現地生産比率増加に伴うコストダウン ・韓国子会社の生産性向上 ・ベトナム子会社の量産効果 <p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DRAM,フラッシュメモリー,液晶パネル等の単価下落に伴う低価格化要請
販管費	1,778	2,097	117.9%	<p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開発強化に伴う開発研究費増加 <p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率化推進によるコスト削減
営業利益	978	1,712	175.0%	
経常利益	902	1,692	187.4%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益	591	1,073	181.4%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

2007年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 実績	増減	増減理由等
流動資産	10,110	11,898	1,787	・手元資金圧縮(有利子負債圧縮) $\Delta 698$ ・売上増加に伴う受取手形及び売掛金増加 +1,762 ・受注増加に伴う棚卸資産増加 +614
固定資産等	8,696	8,853	156	
資産合計	18,807	20,751	1,944	
流動負債	7,138	7,990	852	・売上、受注増加に伴う支払手形及び買掛金増加 +601 ・短期借入金 $\Delta 431$ ・利益増加による未払法人税増加 +362
固定負債	3,642	3,380	$\Delta 262$	・長期借入金減少 $\Delta 302$
負債合計	10,780	11,370	590	
少数株主持分	1,425	—		
資本合計	6,601	—		
負債・資本合計	18,807	—		
純資産合計	—	9,380		・主に韓国子会社少数株主持分相当 +253 ・利益剰余金増加 +1,029 ・為替換算調整勘定 +153
負債及び純資産合計	—	20,751		

2007年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	1,916	550	△1,366
投資活動による キャッシュ・フロー	△967	△393	574
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,179	△935	243
現金及び現金同等物 に係る換算差額	81	96	14
現金及び現金同等物 の減少額	△148	△682	△533
現金及び現金同等物 の期首残高	2,384	2,235	△148
現金及び現金同等物 の期末残高	2,235	1,553	△682

2007年2月期 単体損益計算書

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	7,032	9,138	129.9%	・半導体の微細化を行うデバイスメーカー 及びシリコンウエハーメーカー向けの ウエハソータ・EFEMの販売増加
売上総利益	1,491	2,023	135.7%	【増加要因】 ・売上増収効果 ・ベトナム生産子会社からの仕入価格低減 【減少要因】 ・DRAM,フラッシュメモリー,液晶パネル等 の単価下落に伴う低価格化要請
販管費	1,041	1,064	102.2%	【増加要因】 ・開発強化に伴う開発研究費増加 【減少要因】 ・効率化推進によるコスト削減
営業利益	449	958	213.2%	
経常利益	376	965	256.6%	(営業外損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)
当期純利益	210	567	269.2%	(特別損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)

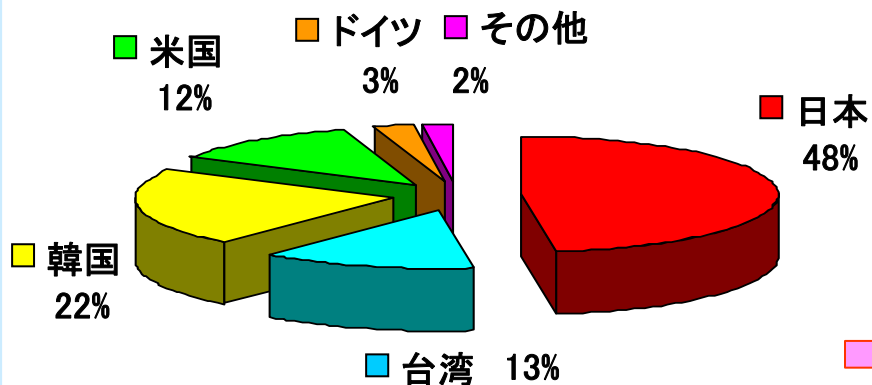
2007年2月期 単体貸借対照表

(百万円)

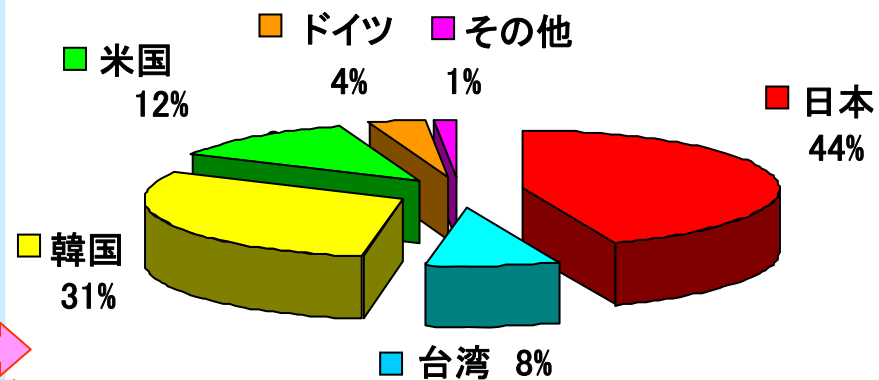
	2006年2月期 実績	2007年2月期 実績	増減	増減理由等
流動資産	7,230	7,928	697	<ul style="list-style-type: none"> ・手元資金圧縮(有利子負債圧縮) $\Delta 831$ ・売上増加に伴う受取手形及び 売掛金増加 $+1,132$ ・受注増加に伴う棚卸資産増加 $+289$
固定資産	8,321	8,064	$\Delta 257$	<ul style="list-style-type: none"> ・時価評価の影響等に伴う投資有価証券の減少 $\Delta 127$ ・関係会社長期貸付金の回収 $\Delta 57$
資産合計	15,552	15,993	440	
流動負債	6,465	6,753	288	<ul style="list-style-type: none"> ・売上、受注増に伴う支払手形 及び買掛金増加 $+425$ ・1年内返済予定長期借入金減少 $\Delta 550$ ・利益増加による未払法人税増加 $+295$
固定負債	2,668	2,379	$\Delta 289$	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金減少 $\Delta 252$
負債合計	9,134	9,133	$\Delta 0$	
資本合計	6,418	—		
負債・資本合計	15,552	—		
純資産合計	—	6,860		別途(任意)積立金増加 $+150$
負債及び純資産合計	—	15,993		

海外売上高(連結)

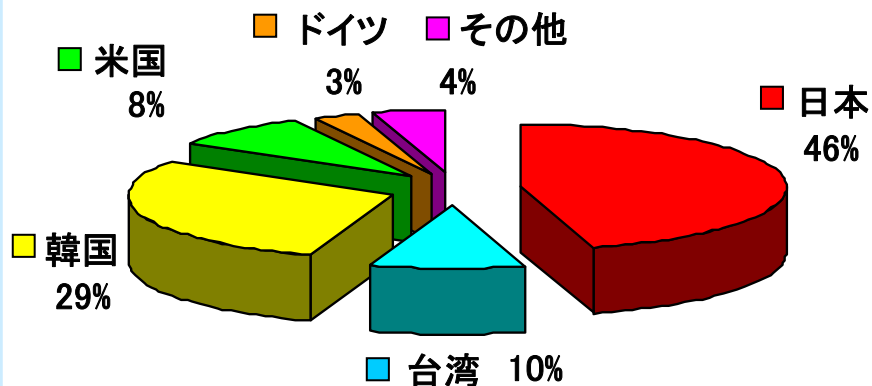
2004年2月期



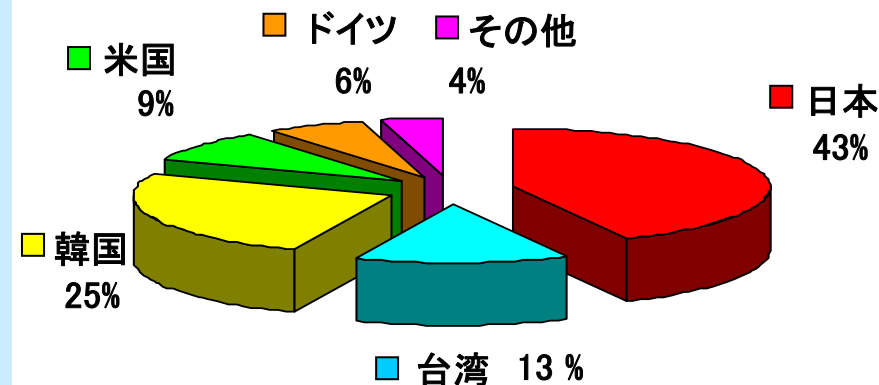
2005年2月期

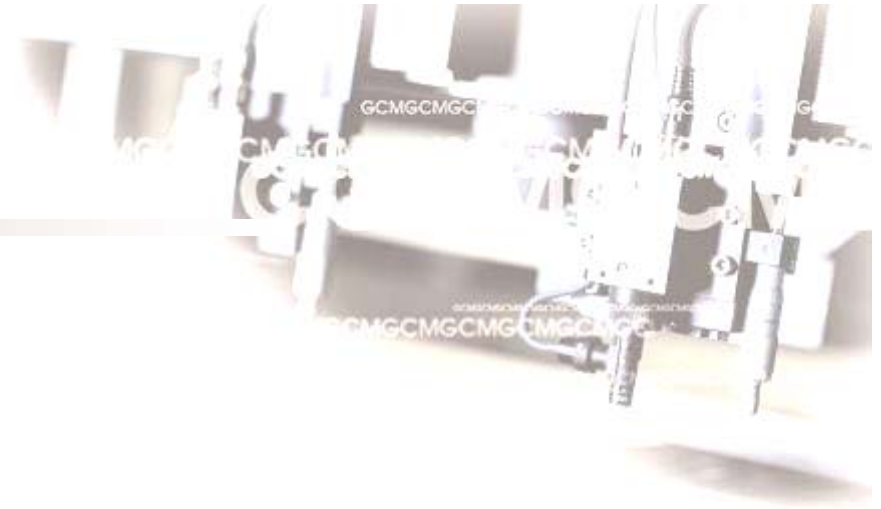


2006年2月期



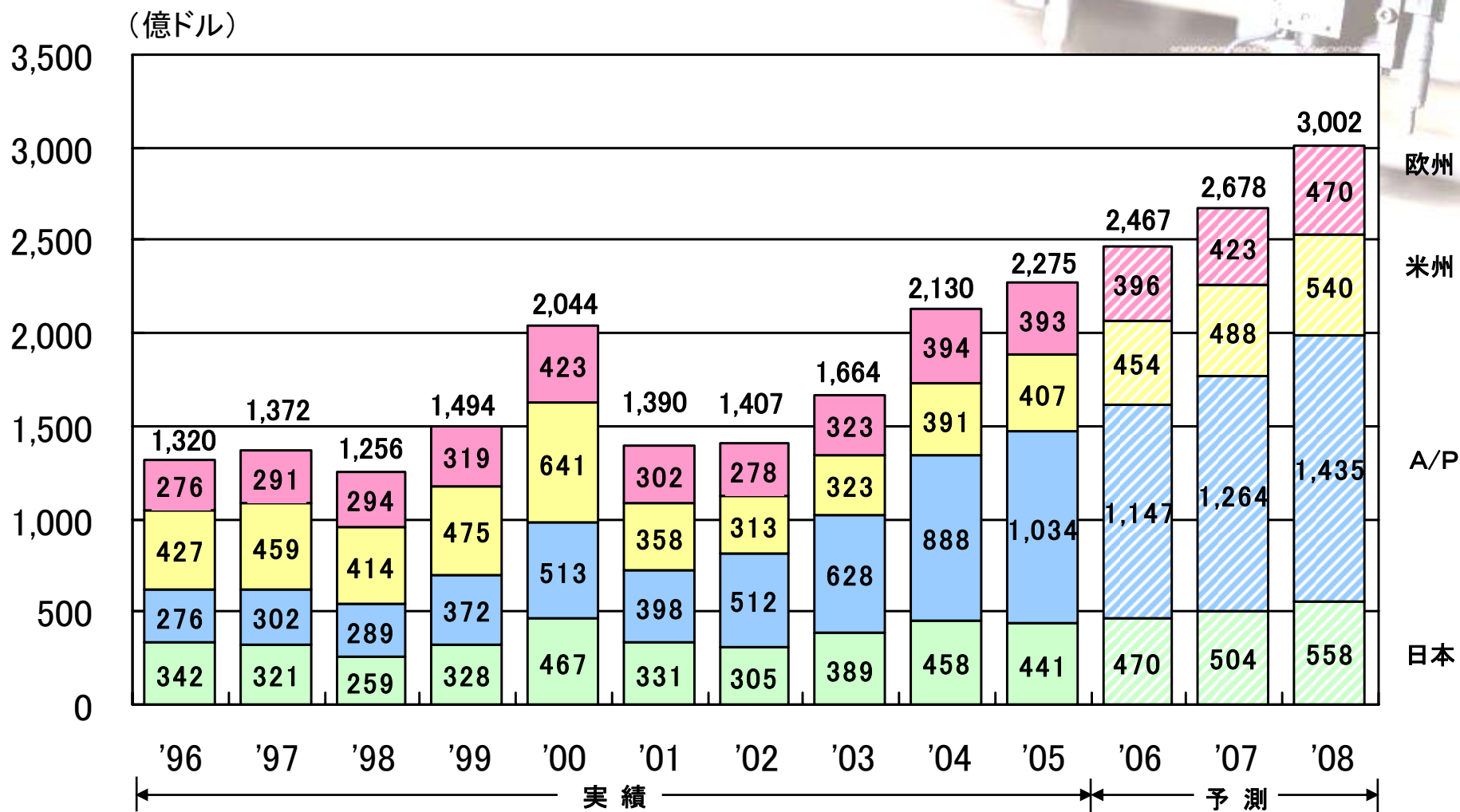
2007年2月期





2008年2月期 業績予想

世界の地域別半導体市場規模

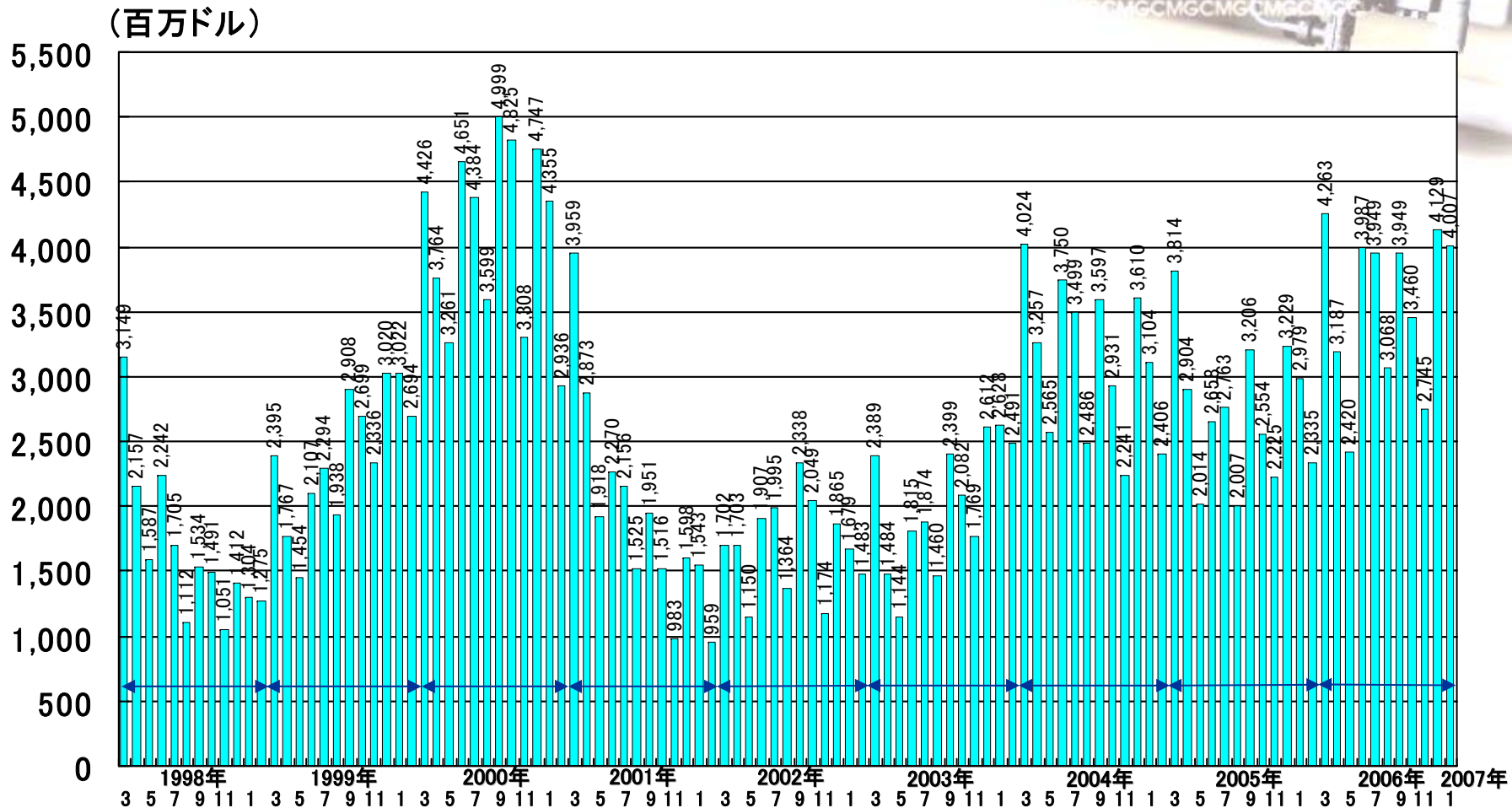


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2006年12月6日付 電波新聞) (2006年10月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計

(2007年1月末現在)



(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2008年2月期 連結業績予想

(百万円)

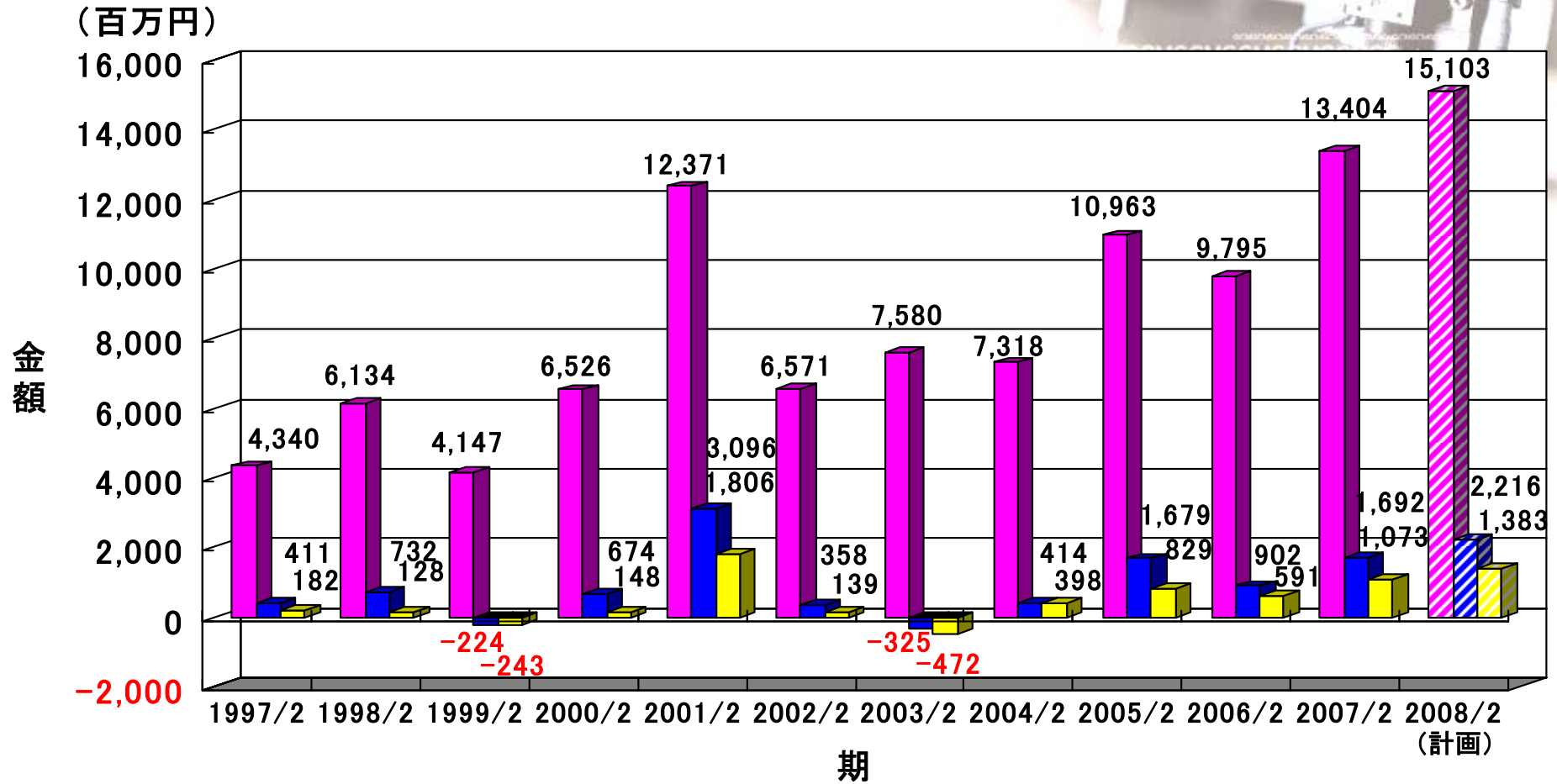
	2007年2月期 実績	2008年2月期 予想	前期比
売上高	13,404	15,103	112.7%
売上総利益	3,810	4,481	117.6%
販管費	2,097	2,190	104.4%
営業利益	1,712	2,290	133.7%
経常利益	1,692	2,216	131.0%
当期純利益	1,073	1,383	128.8%

2008年2月期 単体業績予想

(百万円)

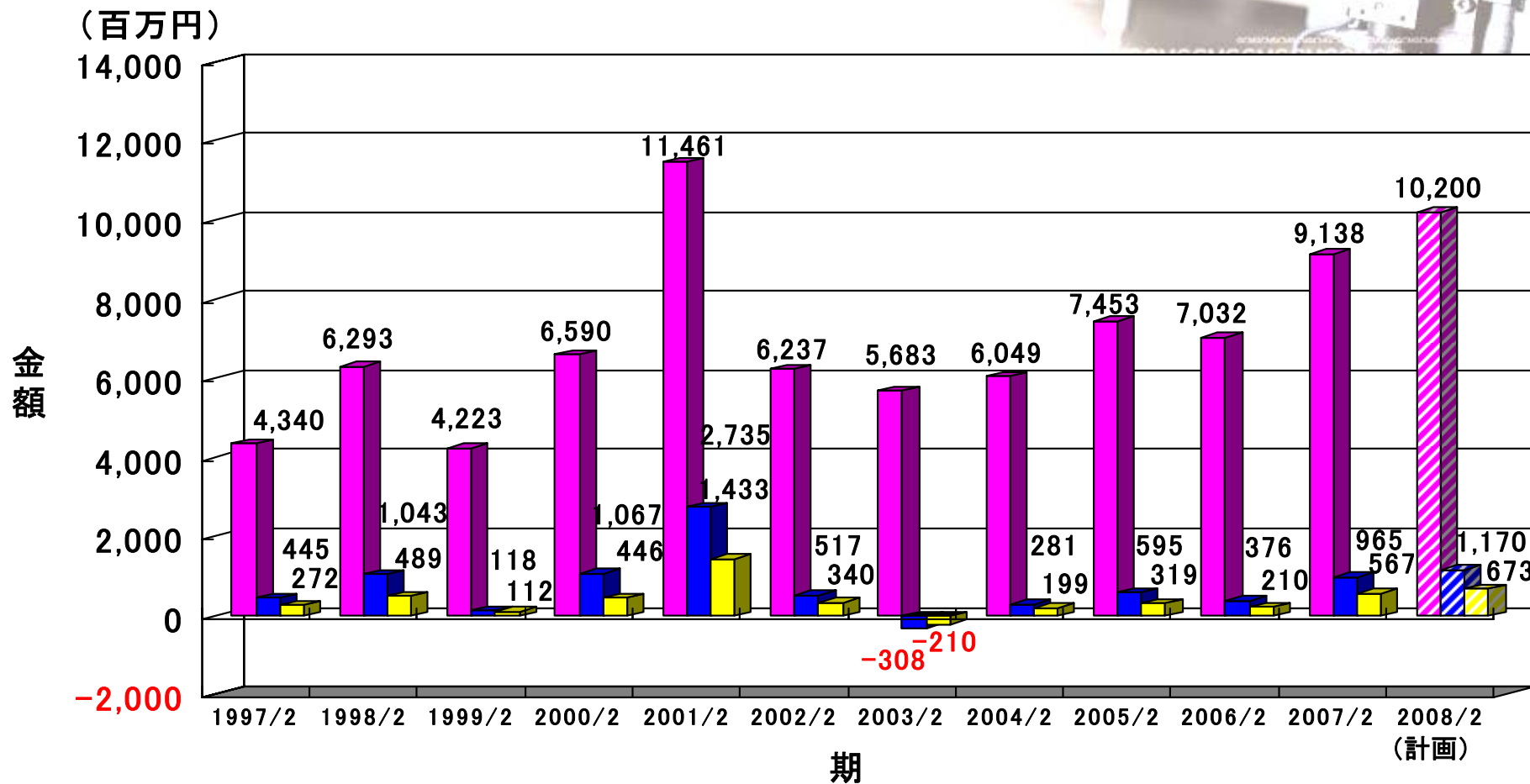
	2007年2月期 実績	2008年2月期 予想	前期比
売上高	9,138	10,200	111.6%
売上総利益	2,023	2,393	118.3%
販管費	1,064	1,109	104.2%
営業利益	958	1,284	133.9%
経常利益	965	1,170	121.2%
当期純利益	567	673	118.6%

連結業績の推移と今期計画



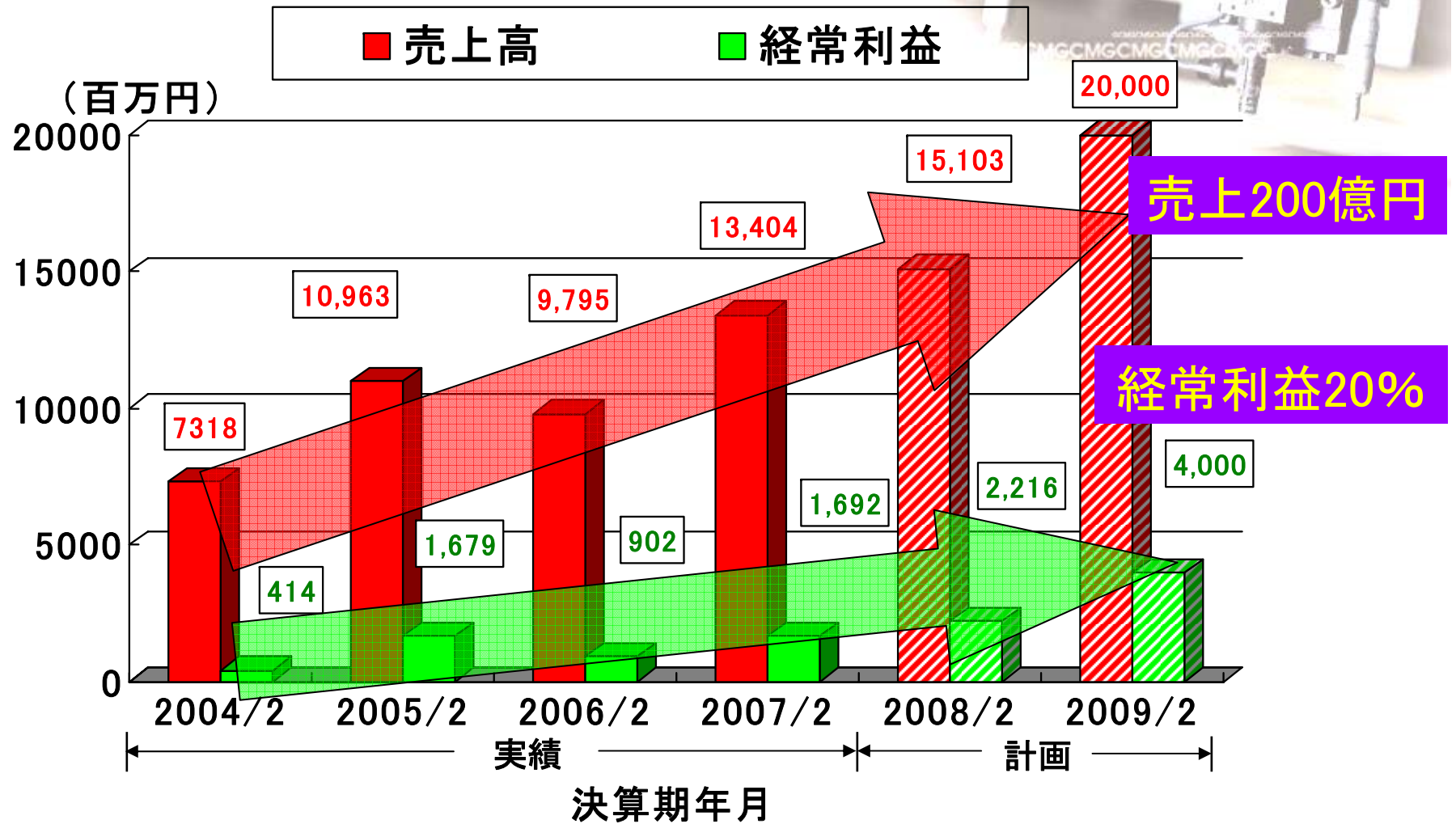
■ 売上高(実績) ■ 経常利益(実績) ■ 当期純損益(実績)

単体業績の推移と今期計画



■ 売上高(実績)
 ■ 経常利益(実績)
 ■ 当期純損益(実績)

チャレンジ5ヶ年計画



注. この資料は当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく目標であり、これら将来の事象、結果について何ら保証するものではありません。



注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。